⑩日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出顧公告

@実用新聚公報(Y2)

 $\Psi 4 - 32817$

Cint. Ci.

独居記号

庁內整理番号

⊗⊕公告 平成4年(1992)8月6日

H 03 H

8731-5 J

(全3頁)

圧電デバイスの保持構造 ❷考集の名称

> 額 平2-121996 ②実

图 平3-77529

昭58(1983) 4 月28日 學出

@平3(1991)8月5日

前特許出願日接用

Ri

神奈川県爲座都築川町小谷2丁片1番1号 豪洋流信機株

式会社内

武文

神奈川県高座都寒川町小谷2丁日1番1号 東洋通信機株

式会让内

变洋通窗镜株式会批 砂出 願

神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号

弁理士 鈴 木 24 多代 理 人

審查官

上 友

60多考文献

実開 昭55-19925(JP, U)

の実用新季意録請求の範囲

圧電巣板の一裏面に形成したインタデイジタ ル・トランスジューサ電極によつて解配単基板表 面成はパルク内に励起する波動を利用する圧電デ パイス基版の電極が形成されていない面を接着四 5 定する保持器の基板支持面に於いて、前記圧電デ パイス基板の共振周波数を決定する電極のほぼ中 央部に対応する部分が当接する該保持器の基板支 特面上に微小面積のランドを突出せしめると無に 適所に該周縁部を非接着伏骸で支持する突起を所 要数数けたことを特徴とする圧電デバイスの保持 術法。

考室の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本著案は圧電デバイス、殊に圧電基板上に形成 したインタデイジタル・トランスジューサ電極に よつて前記基板遊画に励起する被動(以下、 SAWと称する) 或はパルク内に励起する波動 (以下、BSWと称する) 等を利用する圧電浸透デ バイスの保持構造。

(従来技術)

従来上述のような圧電デバイスは第2関に示す

如く圧電デバイス 1 の非電極面をペース 2 の圧電 デバイス支持面3に接着期4を用いて固定すると 共にその電機を前記ペース2を気管質通するリー ドちとボンディング・ワイヤによって電気的に接 著し、然る後に関示を省略した封止蓋を嵌合し前 記ペース2の外間に広がるフランジ6において通 電圧接して外気を遮断する如く収納固定するのが 一般的であった。

しかしながら、断かる方法にて圧電デバイスを 前配圧電耗板の周縁部が当接する基板支持面上の 20 ペースに固定すると前配接着剤は毛管現象によつ て前記圧電デバイス基板の背面と圧電デバイス支 持面との対向面全面に強って展開する為、前記基 板とペースとの熱膨張率の差及び蔣記封止蓋の通 電圧接続にペースに加わるストレスによつて前記 15 圧電基板に歪みを生じ、その共振周波数を変化さ せるという欠陥があつた。

> また、実開昭56-19925号公報には圧電基板を 支持するステム上に高さが同等のもつの突起を設 け、これら突起を十分に覆う舞さに接着剤を塗布 20 したしで、その上に圧電基板を鉄置することによ り、固化前の接着胡上に圧電基板を截置した時に 接着初が横方向へ展開して種々の不具合を起こす ことを防止する構成が閉示されている。しかしな

がら、この公報記載の技術は突起上に支持された 圧電基板の下面とステムとの間に充塡した接着剤 により狂電基板下面を全面接着しているため、上 述のごとく全面接着を行った場合に生じる不具合 を解消することができない。

(考案の目的)

 ζ

本考案は上述のごとき従来の圧電デバイス保持 器の欠陥を除去すべくなされたものであつて、圧 鑑デバイスの保持器への接着面積を必要最小限に 確実に限定することにより、パッケージ完了後実 10 質的に共振周波数の変動を生ぜしめることのない 構造を有する圧電デバイス保持器を提供すること を目的とする。

(考案の概要)

一表面に形成したインタデイジタル・トランスジ ユーサ電響によつて前記圧電差板表面或はパルク 内に励起する波動を利用する圧電デバイス基板の 電極が形成されていない面を接着固定する保持器 の基板支持面に於いて、前記圧電デバイス基板の 共振周波数を決定する電極のほぼ中央部に対応す る部分が当接する該保持器の基板支持面上に微小 面積のランドを突出せしめると共に前記圧電基板 の周縁部が当接する基板支持爾上の適所に該周縁 のである。

(実施例)

以下、本考案は図面に示した実施例に基づいて 詳細に説明する。

第3図は圧電デバイス保持器に封止蓋を通電圧 30 接する際ペースに加わるストレス及びこれによる ベースの変形を説明する図である。

即ち、ペース2に封止蓋を嵌合して前記ペース のフランジ部8において通電圧接する際溶接電艦 Fuだけでなく前記ペース2の圧電デバイス支持 面3の平行な成分Fuが含まれる為、ペース2は 第2図の一点鎖線にて誇張して描いた如く続むと 共にこの撓みは溶接電艦を取り去つた後も残留す るものと考えられる。

この為、ペース2の圧電デバイス支持面3に全 面的に接着固定した狂電デパイス1はそのインタ ディジタル・トランスジューサ電極の電極指間隔

が拡張し、共振周波数が所望の値より低下するも のである。

この問題を解决するため、本考案においては圧 電デバイスをその電極の中央部近傍に相当する極 力小面積の部分のみでペースに接着し得るように ペース形状を改良する。

即ち、第1図4及びbに示す如く前記ペース2 の圧電デバイス支持面のほぼ中央部に微小面積の ランド7を突出せしめるとともに、圧電デバイス (圧電基板) 1の両端縁を非接着状態で支持する ための突起8、8をプレス加工にて形成する。

斯くすることによつて、余剰の接着剤は全てラ ンド7の周辺に流出し圧電デバイスはその共振周 被数を決定する電極のほぼ中央部に相当する位置 上述の目的を達成する為本考案は、圧電基板の 25 だけでペースに固定されることとなるので、ペー スに残留する歪みの影響を受けることが極めて少 ない。更に、前配突起8,8によつて圧電デバイ ス1はペース平面3に対しほぼ平行状態に保たれ るので、前記ランド7の面積を駆取することが可 能となる。なお、前記ランド7及び突起8,8は 第1図bに示す如く線状である必然性はなく、い ずれも点状の領域を有するものであつてもよい。 (考案の効果)

本考案は以上説明した如く構成するので、 邸を非接着状態で支持する突起を所要数設けたも 25 SAW或はBSW共振器又はフイルタ等を接着頬を 用いて保持面に収納固定した場合、封止蓋圧接に 伴うペースの歪を圧電デバイスに伝達することが 殆どなくなるのみならずペースと圧電基板との熱 膨張率の差による影響も極めて少なくなるので、 共振周波数を安定化し、又そのパラツキを減少さ せる上で著しい効果を発揮する。

西面の簡単な説明

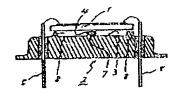
第1図aは本考案に係る圧電デバイスの保持構 造のペース断面図を示す図、同図bはその平面 によって前記ペースに加えられる力には垂直成分 35 図、第2図は従来の圧電デパイスのペースへの接 着要領を示す断面図、第3図はベースに封止蓋を 圧接する際ペースに加わる力とそれによるペース の変形を説明するための模式図である。

> 1 ……圧電基板(圧電振動デバイス)、2 …… 40 保持器 (ペース)、3------- 基板支持面、7------ラ ンド、8……圧電振助デパイス基板周縁支持突 起.

(3)

安公 平 4-3281?

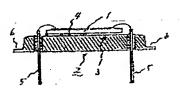
第1图 a



第1图 b



第2巡



独3网

